

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 2 月 10 日 (10.02.2005)

PCT

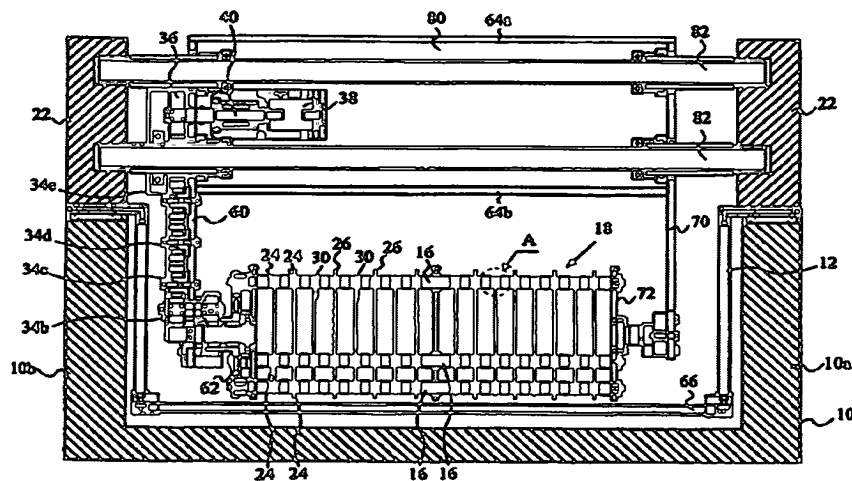
(10) 国際公開番号
WO 2005/013346 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/306 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010808 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮崎 正光
(22) 国際出願日: 2004 年 7 月 29 日 (29.07.2004) (MIYAZAKI, Tadamitsu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮 3 丁目 2 番 1 号 コマツ電子金
(25) 国際出願の言語: 日本語 株式会社内 Kanagawa (JP). 平山 和也 (HIRAYAMA, Kazuya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮
(26) 国際公開の言語: 日本語 3 丁目 2 番 1 号 コマツ電子金株式会社内 Kanagawa (JP). 福永 昌也 (FUKUNAGA, Hisaya) [JP/JP]; 〒
(30) 優先権データ: 特願2003-204248 2003 年 7 月 31 日 (31.07.2003) JP 2540014 神奈川県平塚市四之宮 3 丁目 2 番 1 号 コ
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): コマツ マツ電子金株式会社内 Kanagawa (JP). 二村 公成
電子金株式会社 (KOMATSU DENSHI KINZOKU (FUTAMURA, Hiroyasu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平
KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮 3 丁目 2 番 1 号 コマツ電子金株式
会社内 Kanagawa (JP).
(74) 代理人: 木村 高久, 外 (KIMURA, Takahisa et al.); 〒1040043 東京都中央区銀座 1 丁目 8 番 1 号 千代ビル
6 階 Tokyo (JP).

[図表有]

(34) Title: METHOD AND APPARATUS FOR ETCHING DISK-LIKE MEMBER

(34) 発明の名称: 円板状部材のエッチング方法及び装置



(57) Abstract: Disclosed are a method and apparatus for etching disk-like members, especially a method and apparatus for etching semiconductor wafers. In a method wherein wafers (30) are rotated and etched in an etching chamber (12) which is filled with an etching solution, a non-rotating cell plate (26) is disposed between two rotating wafers (30). In an etching apparatus wherein multiple wafers (30) are supported and rotated by a rod (16), a cell plate (26) is disposed between each two wafers (30). The cell plate (26) has a surface area roughly equivalent to that of the wafer (30).

(57) 要約: 本発明は、円板状の部材のエッチング方法及びエッチング装置に係り、特に、半導体ウェーハのエッチング方法及びエッチング装置に関する。エッチング液を満たしたエッチング槽(12)の内部で、ウェーハ(

[図表有]

WO 2005/013346 A1